

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

本报告期涉及募集资金为经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]127 号文《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准募集的资金（以下简称“非公开发行股票募集资金”）。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]127 号文《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 3 月非公开发行普通股（A 股）股票 10,721,944 股，发行价格为每股 27.98 元，募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用 789.62 万元后，实际募集资金净额为 29,210.38 万元，于 2016 年 3 月存入公司募集资金专用账户中。

上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的众会字（2016）第 3065 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,000.00 万元。

本公司于 2018 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议、于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2018 年 6 月 8 日，公司将尚未使用的募集资金及利息 19,900.29 万元变更用途，其中 16,000.00 万元变更用于投资新设立的子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“上海芯刻微公司”）实施“193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目”，剩余募集资金及存款利息 3,900.29 万元用于永久补充公司流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目变更	年初募集	本年实际	募集资金
	后预算	资金余额	使用金额	年末余额
集成电路制造用 300mm 硅片	10,000.00	-		-
技术研发与产业化项目				
193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目	16,000.00	11,000.00	1,886.28	9,113.72
永久补偿流动资金	3,210.38	-	-	-
合计	29,210.38	11,000.00	1,886.28	9,113.72

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议。

(二) 募集资金在各银行账户的存储及变更情况

本公司为本次募集资金开设了两个专项账户，分别为开户行：上海银行股份有限公司松江支行（以下简称“上海银行松江支行”）账号为 03002836261；开户行：中国建设银行股份有限公司上海荣乐支行（以下简称“建行松江支行”），账号为 31050180400000000039。本公司已连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与上海银行股份有限公司松江支行和中国建设银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》并发表 2016-020 公告。

本公司于 2018 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议、于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议并同意本公司注销原建行松江支行及上海银行松江支行募集资金专用账户。同时，本公司及子公司上海芯刻微公司分别在上海银行松江支行开设账号为 03003614556 及 03003620278 的募集资金专用账户。该专户仅用于子公司上海芯刻微公司进行“193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目”，不得用作其他用途。本公司、上海芯刻微公司于 2018 年 6 月与保荐机构、上海银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司和上海芯刻微公司募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	存放公司	开户银行	账号	期末余额
1	193nm(ArF)干法光刻胶	本公司	上海银行松江支行	03003614556	87,090,268.03
2	研发及产业化项目	上海芯刻微公司	上海银行松江支行	03003620278	7,159,285.21
	合计				94,249,553.24

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金合计 91,137,220.08 元，累计产生利息收入（扣除相应手续费）3,112,333.16 元，余额合计 94,249,553.24 元，均存放于募集资金专项账户中。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，本公司募集资金的使用情况详见附表-1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点或实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 10,000.00 万元，该金额业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 28 日所出具的众会字（2016）第 3305 号《鉴证报告》鉴证。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2019 年末，本公司上述募投项目尚未全部完成。

（六）超募资金使用情况

公司本次非公开发行无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止本年年末，已变更用途的 50,000,000.00 元募集资金已作为注册资本自账号为 03003614556 的公司募集资金专项账户转入账号为 03003620278 的上海芯刻微公司募集资金专项账户，上海芯刻微公司募集资金专项账户中尚未使用的募集余额为 6,901,275.16 元，实际使用募集资金 43,098,724.84 元；已变更用途的 110,000,000.00 元募集资金，仍存于账号为 03003614556 的本公司募集资金专项账

户，该账户中尚未使用的募集余额为 84,235,944.92 元，实际使用募集资金 25,764,055.08 元。上述两个专户中尚未使用的募集资金合计 91,137,220.08 元，累计产生利息收入（扣除相应手续费）3,112,333.16 元，余额合计 94,249,553.24 元。

（八）募集资金使用的其他情况

上海芯刻微设立于 2018 年 05 月，注册资本 10,000 万元（实缴 5,000 万元）。上海芯刻微设立时，公司持有其 80% 的股权、上海逸纳材料科技有限责任公司持有其 20% 的股权。2019 年 05 月，公司协议受让上海逸纳材料科技有限责任公司持有的 20% 股权；2019 年 08 月，上海芯刻微完成股权变更相关的工商信息登记手续，成为公司全资子公司。公司已分别于 2019 年 05 月 10 日、08 月 29 日发布《关于公司受让控股子公司股权的公告》、《关于全资子公司完成工商变更的公告》披露上述事项。

上海芯刻微成立时间较短，累计收益及可使用资金量较少，且品牌认可度仍待提升，无法较快、较好地推动项目进程。为确保项目建设及实现良好收益，公司决定协助上海芯刻微推动项目实施并统筹进行光刻胶项目管理。公司已就上述事项履行了必要的内部审议程序，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.4.1 条的相关规定，实施主体由全资子公司变为上市公司不属于募集资金用途变更，上述事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司开立了两个用于光刻胶研发及产业化项目的募集资金专用账户，存放主体分别为公司及上海芯刻微。为提高资金使用效率，公司将根据实际需要选择并使用上述两个账户剩余的募集资金，用于光刻胶项目相关支出。未来，剩余募集资金无法覆盖的光刻胶项目所需资金部分，公司将以自有资金持续进行投入，实现项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，公司无变更募集资金投资项目及相应使用计划的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

附表 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2020 年 04 月 22 日

附表 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额	29,210.38					本年度投入募集资金总额	1,886.28				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	20,096.66				
累计变更用途的募集资金总额	19,210.38										
累计变更用途的募集资金总额比例	65.77%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现 的效益	截至报告期末 累计实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目											
集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化	是	29,210.38	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	-	-	-869.28	否	否
193nm(ArF)干法光刻胶 研发及产业化项目	新变更项目		16,000.00	1,886.28	6,886.28	43.04%	尚无法判断	-1,150.07	-1,350.06	否	否
永久补充流动资金	新变更项目		3,210.38	-	3,210.38	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计		29,210.38	29,210.38	1,886.28	20,096.66			-1,150.07	-2,219.34		
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		29,210.38	29,210.38	1,886.28	20,096.66			-1,150.07	-2,219.34		

附表 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表（单位：万元）（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目尚未达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 10,000.00 万元。该金额业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2016）第 3305 号《鉴证报告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本年年末，已变更用途的 50,000,000.00 元募集资金已作为注册资本自账号为 03003614556 的公司募集资金专项账户转入账号为 03003620278 的上海芯刻微公司募集资金专项账户，上海芯刻微公司募集资金专项账户中尚未使用的募集余额为 6,901,275.16 元，实际使用募集资金 43,098,724.84 元；已变更用途的 110,000,000.00 元募集资金，仍存于账号为 03003614556 的本公司募集资金专项账户，该账户中尚未使用的募集余额为 84,235,944.92 元，实际使用募集资金 25,764,055.08 元。上述两个专户中尚未使用的募集资金合计 91,137,220.08 元，累计产生利息收入（扣除相应手续费）3,112,333.16 元，余额合计 94,249,553.24 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告中披露的关于集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化投资项目相关效益的计算截止日期为 2018 年 6 月 30 日，因公司已于 2018 年第二季度完成原计划投向上述项目的募集资金的用途变更事宜。本报告期内披露的关于 193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目相关效益计算包含自有资金投入。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表（单位：万元）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 (1)	本报告期实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化	集成电路制造用 300mm 硅片 技术研发和产业化	16,000	1,886.28	6,886.28	43.04%	尚无法判断	-1,150.07	不适用	否
合计		16,000	1,886.28	6,886.28			-1,150.07		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>募集资金原用途为上海新昇半导体科技有限公司 300mm 大硅片项目。300mm 大硅片项目建设需要投入巨大资金，按原规划方案该项目 60 万片/月建成时需投入 68 亿元人民币。2016 年 5 月 20 日由国家集成电路产业基金（大基金）和上海国盛集团共同出资设立上海硅产业投资有限公司（以下简称“硅产业”）投资 3.085 亿元人民币认购上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）增发的全部 2.8 亿元股份，此时上海新昇总股本由 5 亿增加至 7.8 亿元。随后硅产业又将上海新昇原投资股东公司上海新傲科技股份有限公司（以下简称“上海新傲”）和深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）的股份全部收购。至此，硅产业持有上海新昇的股份比例为 62.82%，上海新昇持有的股份变为 24.36%。2017 年 12 月公司以自有资金收购上海皓芯投资管理有限公司（以下简称“上海皓芯”）持有的上海新昇 2,500 万股，公司持有上海新昇的股份变为 27.56%。上海皓芯持有上海新昇的股份变为 9.62%。上海新昇的股权经过前述的多次变动，我公司不再是上海新昇的第一大股东，不再具有对上海新昇的控制权。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，募集资金应由上市公司直接或由上市公司控制的企业使用，公司不能再使用募集资金对上述项目进行投资。公司原投资 300mm 大硅片项目剩余未使用的募集资金及已到期定存利息余额为 19,780.15 万元，本次将其中 1.6 亿元变更用途为用于投资新设立的公司进行 193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目，剩余 3,780.15 万元及未到期存款利息用于永久补充公司流动资金，该资金用于公司主营业务的生产经营活动，降低公司财务成本，提高公司经营效益。上述募集资金变更已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 6 月 8 日，公司完成原募集资金存放专项账户 31050180400000000039（余额人民币 43,675,826.39 元）及 03002836261（余额人民币 155,327,050.47 元）的注销，将 1.6 亿元募集资金按照上述决议转入新的募集资金专户中。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	193nm(ArF)干法光刻胶项目尚处于研发阶段。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								